

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第1区分

【発行日】平成27年1月29日(2015.1.29)

【公開番号】特開2014-26766(P2014-26766A)

【公開日】平成26年2月6日(2014.2.6)

【年通号数】公開・登録公報2014-007

【出願番号】特願2012-164652(P2012-164652)

【国際特許分類】

H 01 R 13/66 (2006.01)

H 05 K 7/20 (2006.01)

【F I】

H 01 R 13/66

H 05 K 7/20 B

H 05 K 7/20 G

【手続補正書】

【提出日】平成26年12月9日(2014.12.9)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0024

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0024】

この回路配置空間113内に配置された内蔵回路15は、MID(Molded Interconnect Device)である。すなわち、この内蔵回路15は、樹脂成形体上に電極や配線パターンの形成や電子部品の搭載がなされている回路部品である。この内蔵回路15には、ほぼ平板の樹脂成形体151上にフォトカプラ152やその他の電子部品が搭載されている。第1のコンタクト12および第2のコンタクト13は、いずれもこの樹脂成形体151に接続されている。そしてこれら第1のコンタクト12と第2のコンタクト13の双方が、直接に又は他の電子部品経由で、その樹脂成形体151に搭載されているフォトカプラ152に接続されている。フォトカプラ152は、第1のコンタクト12と第2のコンタクト13を互いに電気的に絶縁するとともに信号を光で中継する回路素子である。フォトカプラ152は、第1のコンタクト12と第2のコンタクト13とのペア1つにつき1つ備えられている。